

ZUKEN innovation WORLD

2024年10月17日(木) 18日(金)

横浜ベイホテル東急

入場無料

(事前来場登録制)

来場登録申込み

<https://my.zukendigital.com/s/ziwzds/>

本イベントの申込みには、図研のメンバー制サイト
「ZUKEN digital」への登録が必要となります。



Zuken Innovation World 2024 Yokohama

開催のお知らせ

1991年の第1回開催以来、通算で30回目となる図研のプライベート展「Zuken Innovation World 2024 Yokohama」を、2日間の日程にて開催いたします。

図研のビジョンや事業戦略、お客様の先進的な取り組み事例をはじめ、国内外で注目されている企業・大学による貴重な講演を数多くご用意しております。

製造業を変革へ導くアプローチとして注目されるMBSE関連では、国内大手の自動車開発事例や海外の車両開発・鉄道インフラのプロジェクト事例などを発表いただきます。先端半導体関連では、チップレットや3D-IC、異種チップ集積などの技術トレンドや課題、図研の取り組みなどについてご紹介します。

お客様同士や講演者、図研社員との情報交換、コミュニケーションの場としても、この機会を是非ご活用ください。

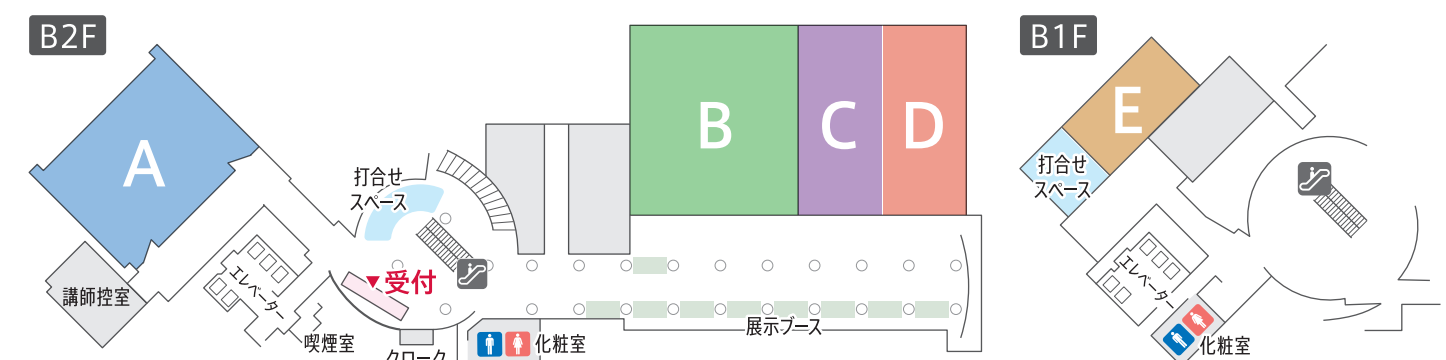
あわせて、時間と場所を選ばず視聴できるオンラインイベント「ZUKEN digital SESSIONS 2024」を10月21日(月)より18日間の日程で本年も開催いたします。

図研製品の開発ロードマップを中心に、お客様の事例や大学・技術パートナーの最新技術動向に関する講演を多数お届けする予定です。

皆さまのご来場、ご視聴を心よりお待ちしております。

株式会社図研

会場図 横浜ベイホテル東急 B1F & B2F



10/17(木)

初日 第 1 講演／ 講演数:1 10:20 ▶ 11:05

ビジョン



会場

B

1B1

図研エンジニアリングITソリューションの総合的ビジョンとロードマップ2024

株式会社図研

専務執行役員 技術本部長 仮屋 和浩

お客様のプロセス革新に貢献するため図研は幅広いテーマに取り組んでいます。ドメインの壁を取り払う総合的設計プラットフォーム。3D-ICや2.5D-ICなど先端技術半導体の後工程設計革新。AI活用自律型自動設計。大規模システム接続のWHジェネラティブ設計。MBSEとPLMを組み合わせたトレーサビリティ実現。図研の最新の取り組みを総合的にご紹介します。



初日 第 2 講演／ 講演数:3 11:20 ▶ 12:00

CR-5000・DS-2導入からCR-8000・DS-CR移行と今後について

会場

B

1B2

ブラザー工業株式会社

IT戦略推進部 IT事業推進グループ スーパーバイザー
中切 将仁 様

2000年のCR-5000・DS-2導入からのツールオプション追加による業務改善、2020年からのCR-8000・DS-CR移行検討展開、今後の課題や図研への要望を講演します。



MBSEを核とした「Digital Engineering Factory」車両設計プロジェクトでの適用事例

会場

C

1C2

The University of Arizona

Department of Systems and Industrial Engineering
Associate Professor Dr. Alejandro Salado

アリゾナ大学では、MBSEモデリングツール GENESYSや要件管理ツール、Pythonによる解析などを組み合わせたデジタルエンジニアリング環境「Digital Engineering Factory」を構築し、有効性を研究しています。本講演では、車両開発プロジェクトにおける取り組み事例を紹介します。



電源ノイズの真実に迫る：PI解析を用いた電源ノイズ対策の極意！！

会場

D

1D2

株式会社オンテック

プリント回路デザイン技術本部 執行役員 技術本部長
徳 正一郎 様

昨年のZdS2023で発表した実験基板の放射ノイズ実測とEMC Adviser EX・PI解析の比較の中で反響の大きかった電源ノイズ対策をさらに深掘りします。新たに作成した46種類の実験基板の実測結果を元に原因と対策手法を紹介します。



GENESYS

ZUKEN MBSE SOLUTIONS

Zuken Innovation Worldでは、ZUKEN MBSE SOLUTIONSと銘打ちMBSEに関する講演をご用意しております。

MBSE マークがあるものが該当講演となります。

初日 第 3 講演／ 講演数:4 13:00 ▶ 13:40

チップレットで設計フローが変わる設計環境も協調がキーに

3D-IC

会場

A

1A3

日本シノプシス合同会社
EDA Group Principal Engineer
古賀 一成 様



アンシス・ジャパン株式会社
技術部エレクトロニクスBU
プリンパルエンジニア-アプリケーション
エンジニアリング 太田 明 様

株式会社図研

技術本部 EL開発部 EL4セクション
セクションマネージャー 菅谷 直之

先端半導体の開発は、機能ごとに最適化したチップレットを3次元実装するアプローチへと進化しており、AIをはじめ、モバイルや車載用途でも注目されています。新しいチップレット3次元実装の課題は、従来の設計ツールや解析手法では解決できません。最先端を走るEDAパートナーであるSynopsys社とAnsys社、そして図研の3社から共同で取り組みをご紹介します。

開発－生産部門間データ連携の取り組み～DFM Center導入道中記～

会場

B

1B3

コーセル株式会社

VE推進開発部 部長 福田 隆之 様

開発－生産部門間のデータやりとりの工数や手戻りが問題となっている。図研の業務アセスメントを機に部門間でのデータプロセスを見直し、当社主要3工場の生産部門と共にDFM Centerの導入を進行中。2024年度の導入完了に向けた取り組みの途中経過を報告する。



オーストラリアの鉄道システム開発におけるGENESYSを用いたMBSE適用事例

会場

C

1C3

Spencer Tech Pty Ltd

Systems Engineer Mr. Daniel Spencer

Spencer TechはMBSEモデリングツール GENESYS の販売、導入、MBSEコンサルティングを担っています。この講演では、オーストラリアの鉄道インフラプロジェクトにおけるGENESYSを用いたMBSEの適用例を紹介します。



ハーネス設計環境に関する取り組みについて

会場

D

1D3

ニチコン株式会社

電源センター 技術管理部 部長 西田 智宏 様

ニチコン株式会社では、家庭用蓄電システムやV2Hシステム、EV用急速充電器など、環境社会への貢献とビジネス拡充へ向けて、独自の新製品の開発や販売活動を進めています。設計環境でボトルネックとなっていた結線図・ハーネス図の設計環境の改善を目的として、図研のハーネス設計ツールを導入した背景や今後の展望について説明します。



初日 第 4 講演／ 講演数:4 14:00 ▶ 14:40

3Dパッケージ技術で切り開く新たな半導体の進化

3D-IC

会場

A

1A4

大阪大学

フレキシブル3D実装協働研究所 所長・名誉教授 菅沼 克昭 様

半導体産業において日本が得意とする領域は、パッケージング材料とプロセス技術にある。日本には一歩先を行く領域の開拓が強く望まれる。目指すべき方向は、微細化はもちろん、信頼性が強く求められる自動車の自動運転とEV化、ビヨンド5G の世界の高速・低ロス通信に加え、徹底的な省エネ化がある。F3Dの活動と今後の展開について述べる。



初日 第 4 講演／ 講演数:4 14:00 ▶ 14:40

プリント基板開発業務DX化への取り組み ～MBSE導入～

MBSE

会場

B

1B4

株式会社明電舎

研究開発本部 製品技術研究所 コアテクノロジ開発部
ハードウェア開発課 主任 赤池 秀一 様



地球温暖化、自然災害の激甚化、少子高齢化による生産人口の減少、情報通信の発展による働き方の変革など、社会環境は予測を超える速さで変化している。明電舎では、それらの変化に対応するため、DX化を推進している。今回、プリント基板開発のDX化を実現するために、MBSEツールGENESYS-CR、データ管理システムDS-CRなどを導入したので、事例として紹介する。

E³.seriesおよびDS-E3による鉄道動力車プラットフォーム管理

E³-J 通訳

会場

C

1C4

Siemens Mobility GmbH

SMO RS LMC EN LM EC CT
E3-Administrator Mr. Marcel Knörlein

Siemens MobilityのVectronプラットフォームは、ヨーロッパ鉄道輸送用に開発された電気、ディーゼル、ハイブリッド動力車のファミリーです。異なった鉄道電力システムや信号システムと互換性を持ち、様々な国をまたいで柔軟に使用できるように設計されています。本講演では、E³.seriesおよびDS-E3によるVectronプラットフォームの電装・電気機器設計と管理について紹介します。



SI・EMIにおけるGND・PDNの重要性とDesign Force活用

会場

D

1D4

RITAエレクトロニクス株式会社

取締役CTO 開発・ソリューション本部担当役員 兼 営業本部長 田中 顕裕 様

SI(信号伝達の完全性)とEMI(放射ノイズ)はともにGNDやPDN(電源供給網)の影響を受けます。SIの検討例としてDDR4-SDRAM搭載基板、EMIについては各種汎用インタフェースを有するEMC評価用電子機器を取り上げます。ともにプリント基板のパターン設計データはCR-8000 Design Forceから出力してシミュレーションを行い、実測との比較からGNDやPDNの重要性を考えます。



初日 第 5 講演／ 講演数:4 15:00 ▶ 15:40

コマツの事業戦略と、建設機械の電装設計の事例紹介

会場

A

1A5

株式会社小松製作所

情報戦略本部 システム推進第1部 部長 稲垣 淑彦 様

近年、建機の情報化や自動化、電動化の研究・開発が進み、電子化や電装技術の重要性はますます高まっています。それと同時に開発期間の短縮も求められるので、当社ではE³.infiniteを導入して、電装設計や生産準備の効率化を進めています。当社の事業戦略と電装設計の事例を紹介します。



半導体アドバンスドパッケージに対するアオイ電子の取り組みについて

会場

C

1C5

アオイ電子株式会社

FOLP事業部 参事 河野 一郎 様

FOLP (FOPLP)をベースとしたアオイ電子のアドバンスドパッケージについてご紹介。具体的には5G、6G向けAiP (アンテナ イン パッケージ) とパワー半導体向けサブモジュールの加工例、さらにパネルレベルのチップレット集積技術PSB (ピラーサスペンディッドブリッジ) のPoC、信頼性結果を説明します。



初日 10/17 (木) time

A会場	B会場	C会場	D会場	TIME	プログ
				9:50	受付
1B1 中継	1B1 同時通訳			10:20 11:05	第 1
				11:05	休
1B2 中継	1B2	1C2 同時通訳	1D2	11:20 12:00	第 2
				12:00	休
1A3	1B3	1C3 同時通訳	1D3	13:00 13:40	第 3
				13:40	休
1A4	1B4	1C4 同時通訳	1D4	14:00 14:40	第 4
				14:40	休
1A5	1B5 同時通訳	1C5	1D5	15:00 15:40	第 5
				15:40	休
1B6 中継	1B6 同時通訳			16:10 16:50	第 6
		懇親PARTY?		16:50	

懇親PARTY? お客様、ご講演者様、図研社員も交えての情報交換会です。お気軽にご参加ください。

自動車開発の効率化・高度化に向けた「思考と仕事の流れ」のデジタル化

MBSE

J+E 通訳

会場

B

1B5

本田技研工業株式会社

電動事業開発本部 BEV開発センター BEV企画統括部
開発プロセス改革部 開発プロセス課 光山 慎一郎 様
四輪事業本部 四輪開発センター パワーユニット開発統括部
パワーユニット開発二部 電動モジュール開発課 竹内 大裕 様



HondaのこれまでのSE/MBSE活動の取り組みから、効果的にSE/MBSEを実践するために何に気を付けるべきか、特にシステムズエンジニアが個人の力で太刀打ちできない大規模・複雑なシステム開発において、デジタルの力を借りた情報マネジメントによって開発活動をより効率化・高度化し、協調しながら開発をサポートする体制をどのように整えて実践につなげようとしているか、事例を交えて紹介します。

LPDDR5メモリのA/W設計手法及び検証結果

会場

D

1D5

株式会社エム・ディー・システムズ

取締役 営業部 部長 兼 第二設計部 部長 難波 義幸 様
技術支援部 部長 小川 英智 様

LPDDR5メモリのA/W設計を行いSI解析による検証を実施した結果、さまざまな問題が見えてきました。A/W設計時の失敗事例や苦労した点、Design Forceの機能を活用してそれらの問題を改善する手法を紹介します。

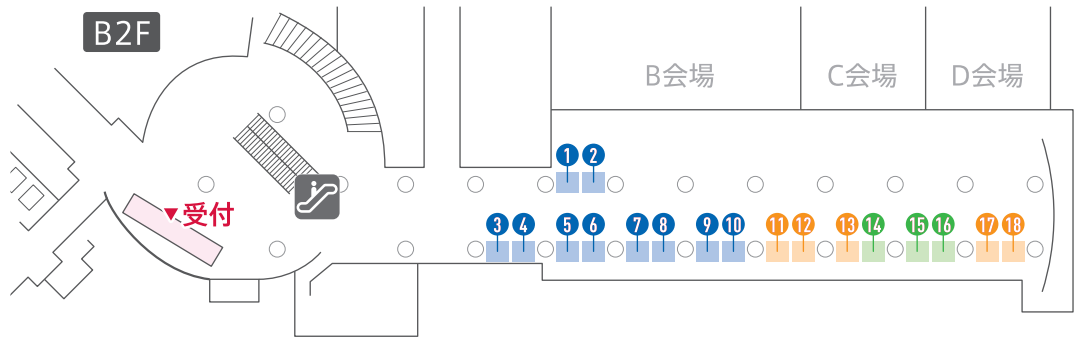


エキスペリエンス開催情報

B1F E会場

10/17 (木)	1E2	Design Gateway 11:20 ▶ 12:00	設計の二度手間をなくす！ 「Design Gateway」2024 最新検証機能とLTspice活用	
	1E3	Design Force 13:00 ▶ 13:40	メカ設計情報を基板設計にスマートイン！ 物理干渉もEMC対策も「Design Force」+「3D EMC Adviser」でイノベーション	
	1E4	Design Force 14:00 ▶ 14:40	基板流用設計の自動化・効率化で設計資産を有効活用！ 「Design Force」2024 最新機能+「DFM Center」リファレンスデザイン活用	
	1E5	Design Force 15:00 ▶ 15:40	さあ、はじめよう！ 「Board Designer」→「Design Force」移行の準備のいろはと効果体感	
	1E6	DS-E3 for E ³ .series 16:10 ▶ 16:50	エレキBOMに情報を徹底集約！ 「DS-E3 for E ³ .series」が実現する間違いのないモノづくり	
10/18 (金)	2E2	GENESYS-CR 11:20 ▶ 12:00	エレキ仕様の影響範囲が一目でわかる！ 「GENESYS-CR」でエレキの設計変更対応を効率化	MBSE
	2E3	E ³ .series for EC 13:00 ▶ 13:40	電気計装設計をデジタル化！ 「E ³ .series for EC」による積算業務の効率化	
	2E4	GENESYS 14:00 ▶ 14:40	製品の特性が正しくわかる、伝達できる！ 「GENESYS」によるシステムモデル活用術	MBSE
	2E5	E ³ .series 15:10 ▶ 15:50	"正しく素早く"を徹底！ 「E3 Service Utilities」最新機能活用術	

展示ブース情報



図研製品
&
サービス

- ① E³.infinite, E³.series
- ② E3 Service Utilities, E³.series for EC, XVL Studio WR
- ③ DS-CR, DS-2 Espresso, DS-OP
- ④ DS-E3
- ⑤ GENESYS, GENESYS-CR
- ⑥ CR-8000 System Planner, CR-8000 Design Gateway, CR-8000 Circuit DR Navi
- ⑦ CR-8000 Design Force, Autonomous Intelligent Place and Route
- ⑧ CR-8000 Design Force, 3D EMC Adviser
- ⑨ CR-8000 DFM Center, ADM
- ⑩ CR-8000 Design Force, Co-Design, 3D-IC, MEMS Designer

テクノロジー
パートナー

- ⑪ 日本シノプシス
- ⑫ アンシス・ジャパン
- ⑬ ダッソー・システムズ
- ⑭ SCSK/日立製作所
- ⑮ ラティス・テクノロジー

ビジネス
パートナー

- ⑭ ムラタソフトウェア
- ⑮ 図研モデリンクス
- ⑯ 図研プリサイト



ACCESS

横浜ベイホテル東急 受付・会場:B2F

〒220-8543 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-7

最寄駅

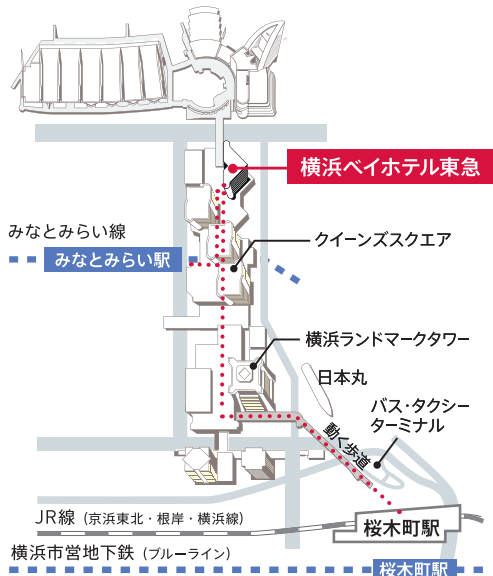
- ・みなとみらい線（東急東横線直通）「みなとみらい駅」直結 徒歩 約 2 分
- ・JR（京浜東北・根岸・横浜線）、横浜市営地下鉄「桜木町駅」から 徒歩 約 15 分

新幹線「新横浜駅」からのアクセス

- ・「新横浜駅」—横浜市営地下鉄—「桜木町駅」
- ・「新横浜駅」—JR 横浜線—「菊名駅」乗換え—東急東横線（みなとみらい線直通）—「みなとみらい駅」



横浜ベイホテル東急 公式HP／アクセス情報
<https://ybht.co.jp/access/>



【注意事項】

- ※ 本イベントは事前来場登録制です。登録のない方のご入場はお断りしています。
- ※ 席数に限りがあるため、各講演会場への入室の際に受講票のご提示をお願いする場合があります。
- ※ 本イベントに関するご質問は下記イベント運営事務局へお問い合わせください。

【Zuken Innovation World 運営事務局】

contact@zuken-ds.jp

【個人情報の取り扱いについて】

ご登録いただいた個人情報は、本イベントの実施運営、今後のイベント・セミナー開催や製品・サービスのご案内のために利用いたします。
また、イベントの円滑な運営をはじめとした目的達成のため、当社グループ各社及び委託・提携先（配送業者等）で個人情報を利用することがありますので、予めご了承ください。
なお、当社の個人情報保護方針については https://www.zuken.co.jp/privacy_policy/ をご覧ください。